



特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 真空+氢气保护焊接技术
- 体积小，重量轻

典型应用

- 交直流电极控制,工业加热控制,调光,无触点开关
- 电机软启动,静止无功补偿,电焊机
- 变频器，UPS电源，电池充放电

$I_{F(AV)}$	800A
V_{RRM}	500-2500V
I_{FSM}	18 KA
I^2t	1650 $10^3 a^2 s$

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波，50HZ 单面散热， $T_C=100^{\circ}C$	150			800	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			1256	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	500		2500	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			40	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽，正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	150			18.0	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					1650	$A^{2s} \cdot 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻					0.34	mΩ
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=2400A$	25			1.40	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热				1.72	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗（壳至散）	180° 正弦波，单面散热				0.080	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		2500			V
F_M	安装扭矩 (M5)				12		N-m
	安装扭矩 (M6)				6		N-m
T_{stq}	储存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Outline	外形						

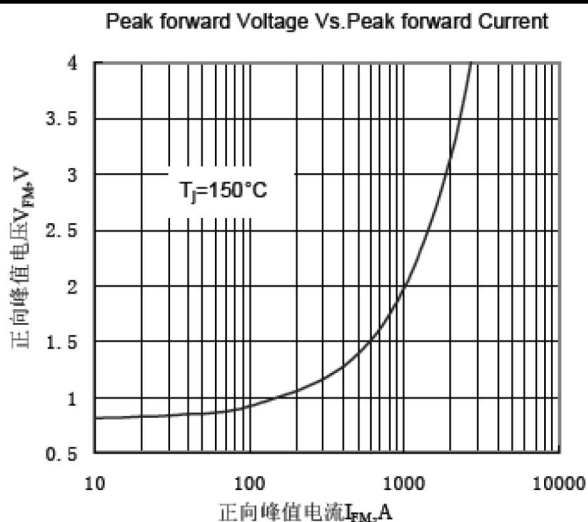


Fig.1 正向伏安特性曲线

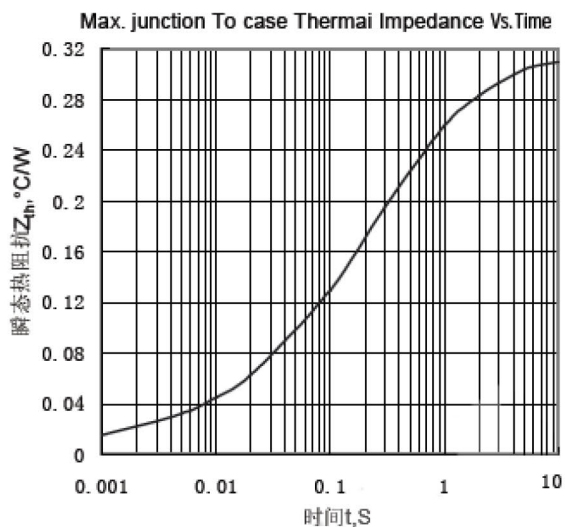


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

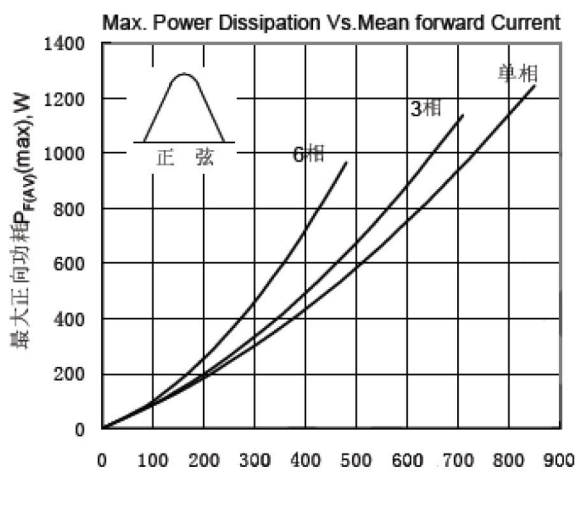


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

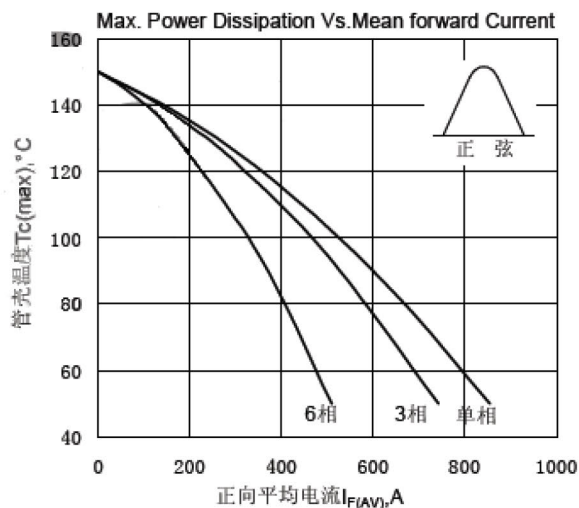


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

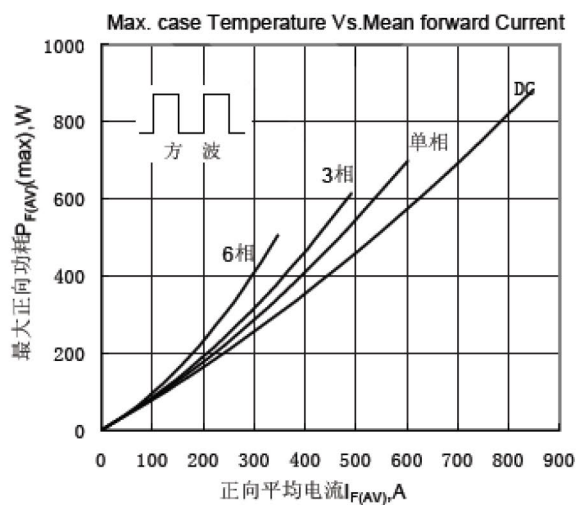


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

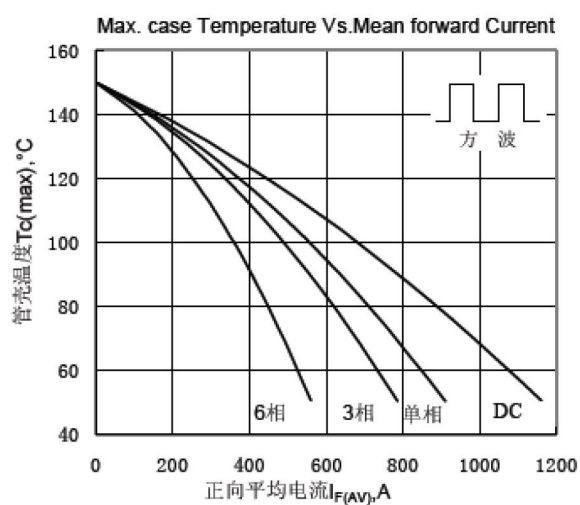


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线



上整整流器
RECTIFIER
SHANGZHENG®

MDC、MDK、MDA、MDK、MD、SKKD、MDD800A 普通整流管模块

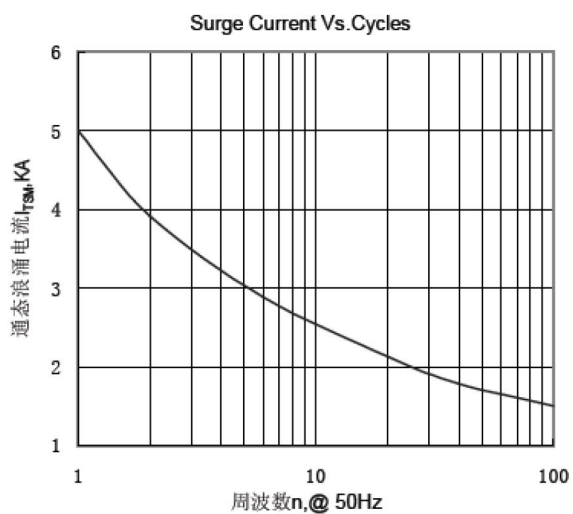


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

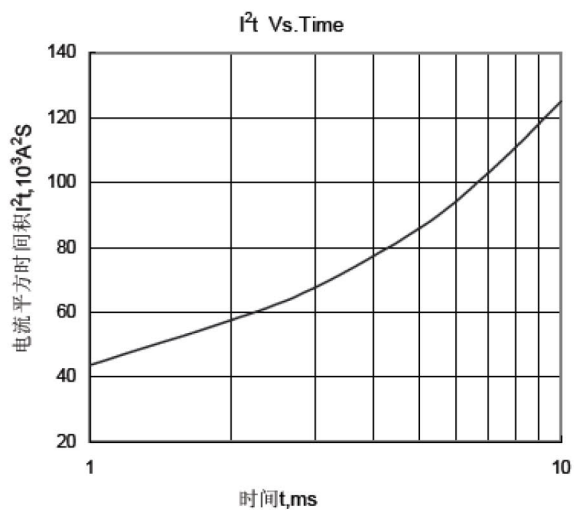
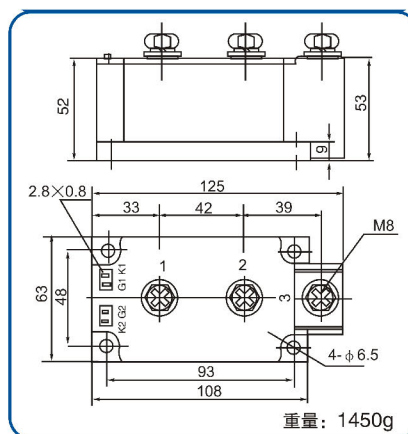


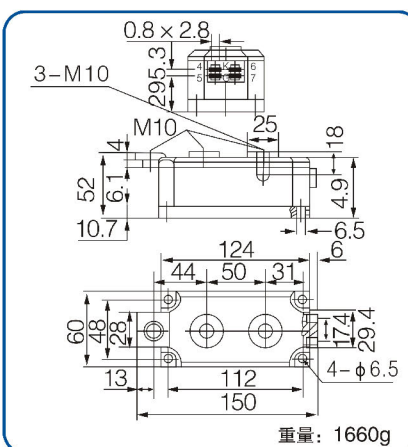
Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图:

代号: 501F



代号: 501C



线路图:

